

情况说明

本次与申微半导体（西安）有限公司签署基于 TSV 的埋埋式硅基扇出工艺样片制造合同，经费列支于测试化验加工费，从集成电路高精尖创新中心项目支出，经费支出账号 8300200052。

由于集成电路高精尖创新中心项目未制定预算明细，根据任务需要，经考察和比较，申微半导体（西安）有限公司可在限定时间内提供和完成符合要求的流片加工服务，因此现申请与其签订合同并做相应支出。

